

2013-2014年全球及中国硬质PCB行业研究报告

《2013-2014年全球及中国硬质PCB行业研究报告》包含以下内容：

- 1、全球PCB产业简介
 - 2、PCB下游市场分析
 - 3、PCB发展趋势
 - 4、光电、笔记本电脑、汽车、内存PCB产业分析
 - 5、PCB行业排名
 - 6、33家PCB厂家研究
-
- PCB行业可分硬板（Rigid PCB）、软板（FPCB）、载板（Substrate）三大类。软板和载板属于新兴领域，早期PCB行业只有硬板，虽然近年来软板和载板发展迅速，但是硬板所占比例仍然超过50%，并且不少硬板PCB厂家的利润率并不比软板和载板低。
 - PCB行业是成熟的行业，市场增幅一般不超过6%，而硬板厂家的产值一直以来都处于下滑趋势中。2012年是硬板厂家尤其难过的一年，智能手机和平板电脑市场爆发，让硬板厂家展开激烈的价格战，导致利润和收入下滑，大型PCB厂家认为传统硬板缺乏成长空间，纷纷投入软板或载板。2013年除大陆以外的硬板厂家几乎全面回暖，2014年硬板厂家效益更好，回暖更明显。

- 大型PCB厂家未来的拓展方向集中在载板和软板领域，对硬板则只是维持现状，主要拓展载板的厂家有欣兴、SEMCO、LG INNOTEK、AT&S、DAEDUCK、深南电路、SIMMTECH。
- 主要拓展软板的厂家有臻鼎、young pong集团、DAEDUCK GDS。唯一致力于拓展硬板领域的PCB大厂只有Ibiden。还有部分大厂垂直拓展进入EMS领域，如笔记本电脑PCB第一大厂瀚宇博德（Hannstar Board）和健鼎。这将导致未来传统硬板领域供需更加平衡，而高端的Any layer乃至HDI出现明显的供不应求。
- 2014年硬板行业加速回暖的另一个原因是日系PCB厂家开始退出。
- 2013年11月日本松下（Panasonic）宣布大举缩减全球PCB产能，预计2015年第1季以前停产约九成。2013年松下的PCB事业收入大约3.1亿美元，松下的PCB业务，主要是自行研发的ALIVH（Any Layer Interstitial Via Hole）制程，应用在智能型手机领域。2013年3月松下就已传出将缩减台湾、越南的PCB产能，位在桃园县大园乡工厂更是2012年3月中旬才开幕，当时应是争食HTC订单而新设。然而2013年HTC出货量锐减，导致松下产能利用率极低，遂决议退出。
- 日本汽车PCB大厂CMK也效仿松下，2014年1月宣布2014年4月30日关闭旗下PCB生产据点YAMANASHI SANKO、并停止生产手机用多层PCB ALIVH产品。目前还在使用ALIVH技术只剩下奥地利的AT&S。
- 日系PCB也出现并购趋势，京瓷在2013年8月收购了NEC-TOPPAN，未来富士通的PCB业务也有可能出售，Daisho Denshi可能和Hitachi Chemical的PCB业务合并。



		2012	2013	2014E
TRIPOD健鼎	Taiwan	1326	1377	1388
TTM	USA	1349	1368	1398
Compeq华通	Taiwan	783	1051	1158
Viasystems意亚	USA	967	1008	1028
Hannstar board瀚宇博德	Taiwan	1112	976	958
Unimicron欣兴	Taiwan	1049	889	918
ZDT臻鼎	Taiwan	908	871	850
Kingboard PCB建滔	China HK	935	860	830
MEIKO明幸	Japan	759	818	860
AT&S	Austria	698	780	838
CMK	Japan	908	见报告	见报告
SEMCO三星电机	South Korea	792	见报告	见报告
Chin Poon Industry敬庭工业	South Korea	595	见报告	见报告
WUS Group腾梓集团(沪士)	Taiwan	644	见报告	见报告
T.P.T志超	Taiwan	722	见报告	见报告
MULTEK超毅	USA	650	见报告	见报告
Gold Circuit Electronics金像电子	Taiwan	509	见报告	见报告
IBIDEN	Japan	455	见报告	见报告
Unitech PCB耀华	Taiwan	433	见报告	见报告
ISU PETASYS	South Korea	390	见报告	见报告
HITACHI CHEMICAL日立化成	Japan	494	见报告	见报告
Shennan Circuits深南电路	China Mainland	345	见报告	见报告
Ellington依顿电子	China Mainland	440	见报告	见报告
LG INNOTEK	South Korea	408	见报告	见报告
Founder Technology PCB方正科技PCB	China Mainland	366	见报告	见报告
Dynamic Electronics定颖	Taiwan	372	见报告	见报告
NANYA PCB南亚电路板	Taiwan	350	见报告	见报告
KYODEN	Japan	386	见报告	见报告
DAEDUCK GDS大德GDS	South Korea	350	见报告	见报告
KYOCERA Circuit	Japan	412	见报告	见报告
REDBOARD	China HK	290	见报告	见报告
Wuzhou Group五株集团	China Mainland	270	见报告	见报告
DAP	South Korea	295	见报告	见报告
DAEDUCK ELECTRONICS大德电子	South Korea	280	见报告	见报告
Shirai Denshi	Japan	281	见报告	见报告
CCTC超声电子	China Mainland	286	见报告	见报告
Gul Technologies高德	Singapore	267	见报告	见报告



报告目录

第一章、PCB产业概况

- 1.1、全球PCB产业产值
- 1.2、PCB产业近况与未来趋势
- 1.3、台湾PCB产业
- 1.4、中国大陆PCB产业
 - 1.4.1、中国大陆PCB产业规模
 - 1.4.2、中国大陆PCB政策
- 1.5、大陆PCB厂家排名
- 1.6、欧洲PCB产业
- 1.7、北美PCB产业

第二章、PCB下游市场

- 2.1、手机
 - 2.1.1、全球手机市场规模
 - 2.1.2、手机品牌市场占有率
 - 2.1.3、智能手机市场与产业
 - 2.1.4、中国手机市场
 - 2.1.5、中国手机产业
- 2.2、PC市场
 - 2.2.1、笔记本电脑产业

- 2.2.2、笔记本电脑代工
- 2.2.3、平板电脑产业
- 2.2.4、中国移动PC产业

第三章、PCB产业分析

- 3.1、PCB技术趋势
 - 3.1.1、手机PCB厂家排名
 - 3.1.2、手机PCB配套关系
- 3.2、内存模块PCB
- 3.3、光电板
- 3.4、汽车电子PCB
- 3.5、笔记本电脑PCB
- 3.6、全球PCB厂家排名

第四章、主要PCB厂家研究

- 4.1、欣兴
- 4.2、华通
- 4.3、瀚宇博德
- 4.4、金像电子
- 4.5、健鼎
- 4.6、名幸MEIKO
- 4.7、CMK



- 4.7.1、无锡希门凯
- 4.7.2、瑞升科技
- 4.7.3、旗利得电子
- 4.8、IBIDEN
- 4.9、大德电子
- 4.10、TTM
- 4.11、耀华
- 4.12、AT&S
- 4.13、建滔
- 4.13.1、依利安达
- 4.13.2、科惠线路板
- 4.13.3、扬宣电子Express Electronics
- 4.14、SIMMTECH
- 4.15、志超T.P.T
- 4.16、依顿电子
- 4.17、敬鹏
- 4.18、LG INNOTEK
- 4.19、SEMCO
- 4.20、方正电路板
- 4.21、高德电子
- 4.22、定颖
- 4.23、惠亚
- 4.24、南亚电路板
- 4.25、深南电路
- 4.26、沪士电子
- 4.27、超声电子
- 4.28、臻鼎ZDT
- 4.29、MULTEK
- 4.30、景硕
- 4.31、SHINKO
- 4.32、ISU PETASYS
- 4.33、KYOCERA CIRCUIT SOLUTIONS



图表目录

- 2001-2015年PCB产业产值
- 1980-2001年全球PCB产值
- PCB产业链
- 2009-2015年PCB产业收入分布（分技术）
- 2013年全球PCB产值by layer
- 2013、2017年全球PCB产业收入地域分布
- 2012-2014年全球PCB产业收入地域分布
- 2010-2013年台湾PCB产业收入产品分布
- 2001年1月-2014年4月台湾PCB厂家收入
- 2010-2011年中国大陆PCB企业投资结构
- 2011-2013年大陆PCB产业产值技术分布
- 2013年大陆PCB厂家收入排名
- 2013 European PCB Production by End Market
- 2013年欧洲PCB厂家收入国别分布
- 2000-2013年欧洲PCB厂家收入国别分布
- 2009-2013年欧洲主要PCB厂家季度收入
- 2005-2017年欧洲PCB厂家产值增幅
- 2013年欧洲TOP50 -PCB厂家
- 2008年1季度-2014年1季度北美主要PCB厂家收入
- 2005-2017年北美PCB产值增幅



- 2007-2014年全球手机出货量
- Worldwide Mobile Phone Sales to End Users by Vendor in 2013
- 2011-2013中国主要厂家智能手机出货量
- Worldwide Smartphone Sales to End Users by Vendor in 2013
- Worldwide Smartphone Sales to End Users by Operating System in 2013
- 2013年1月-2014年5月中国手机市场出货量
- 2014年1季度中国手机市场主要厂家市场占有率
- 2013年2-12月中国手机月度产量
- 2008-2015年全球PC出货量
- 1999年-2013年全球PC出货量
- 2014年1季度全球PC出货量地域分布
- 2008-2015年笔记本电脑出货量
- 2010-2013年全球主要笔记本电脑ODM厂家出货量
- 2006、2008年主要笔记本电脑代工厂家市场占有率
- 2010年全球笔记本电脑品牌厂家与代工厂家之间配套关系及出货比例
- 2011年全球笔记本电脑品牌厂家与代工厂家之间配套关系及出货比例
- 2011-2016年全球平板电脑出货量
- 2013年平板电脑主要品牌市场占有率
- 2012、2013年全球平板电脑制造厂家产量
- 2004-2012年中国笔记本电脑（包括平板电脑）产量
- 2010-2012年中国笔记本电脑产量（包括平板电脑）地域分布
- 2012-2013年主要HDI厂家收入排名



- 2010-2013年NOKIA手机PCB供应商供应比例
- 2010-2013年SAMSUNG手机PCB供应商供应比例
- 2012年LG手机PCB供应商供应比例
- 2010-2013年ZTE手机PCB供应商供应比例
- 2010-2011年RIM手机PCB供应商供应比例
- 2010-2013年APPLE PCB供应商供应比例
- 2010-2013年内存PCB厂家市场占有率
- 2006\2010\2011\2012年光电板主要厂家市场占有率
- 2010-2013年汽车电子PCB厂家收入市场占有率
- 2011-2012年笔记本电脑PCB板主要厂家市场占有率（按出货量）
- 2012-2014年全球PCB硬板厂家收入前37名
- 2012-2014年主要PCB厂家毛利率
- 2012-2014年25大PCB厂家营业利润率
- 2003-2014年欣兴收入与毛利率
- 2009-2014年欣兴收入与营业利润率
- 2012年1季度-2014年1季度欣兴季度收入与毛利率
- 2010-2014年欣兴销售额技术分布
- 2010-2014年欣兴收入下游应用分布
- 2010-2014欣兴产能Capacity
- 2004-2013年欣兴CAPEX
- 欣兴历年合并
- 2013年欣兴大陆子公司财务数据



- 2006-2014年华通收入与毛利率
- 2009-2014年华通收入与营业利润率
- 2012年5月-2014年5月华通每月收入与增幅
- 2009-2013年华通主要子公司财务数据
- 瀚宇博德关系企业图
- 2006-2014年瀚宇博德收入与毛利率
- 2009-2014年瀚宇博德收入与营业利润率
- 2012年5月-2014年5月瀚宇博月度收入与增幅
- 2009-2012年瀚宇博收入下游应用分布
- 2009-2012年瀚宇博收入Layer分布
- 2013年瀚宇博德主要子公司财务数据
- 2005-2014年金像电子收入与毛利率
- 2009-2014年金像电子收入与营业利润率
- 2012年5月-2014年5月金像电子 每月收入与增幅
- 2010-2012年金像电子收入产品分布
- 2006-2014年健鼎收入与毛利率
- 2012-2014年健鼎收入与营业利润率
- 2013年健鼎收入by application
- 2013年健鼎收入by layer
- 2012年5月-2014年5月健鼎每月收入与增幅
- 2006-2011年健鼎产能
- 2013年健鼎大陆子公司财务数据



- 2006-2013财年名幸电子收入与运营利润率
- FY 2014名幸电子营业利润分析
- 2009-2012财年名幸电子大陆子公司收入与运营利润率
- 2013财年-2015财年名幸电子收入下游应用分布
- 2010财年-2015财年名幸电子收入技术分布by layer
- 2005-2015财年CMK收入与运营利润率
- 2007-2014财年CMK收入下游应用分布
- 2007-2014财年 CMK收入by layer
- 2007-2014财年 CMK收入地域分布
- 2003-2010年无锡希门凯收入与产量
- 2012年2季度-2014年1季度IBIDEN季度收入业务分布
- 2012年2季度-2014年1季度IBIDEN季度营业利润业务分布
- 2010-2015财年ibiden电子事业部收入产品分布
- 2010-2015财年ibiden CAPEX与depreciation
- 2005-2014年大德GDS收入与运营利润率
- 2010-2014年大德GDS收入业务分布
- 2005-2014年TTM收入与运营利润率
- 2011-2013年TTM收入地域分布
- 2013年TTM Revenues by technology
- 2008-2013年TTM收入下游应用分布
- TTM全球工厂分布
- 2006-2014年耀华收入与毛利率



- 2009-2014年耀华收入与营业利润率
- 2012年5月-2014年5月耀华月度收入与增幅
- 硬板技术路线图
- 软硬板技术路线图
- 上海展华电子2010、2013 财务数据
- 2005-2014财年 AT&S与EBITDA率
- AT&S重庆substrate厂ramp
- FY2014 AT&S收入地域分布
- FY2014 AT&S资产负债表
- 建滔集团组织结构
- 2002-2012年建滔集团收入与股东应占利润率
- 2009-2014年建滔集团收入与税前利润率
- 2008-2013年建滔集团收入业务分布
- 依利安达组织结构
- 2005-2013年依利安达收入与运营利润率
- 2009-2013年依利安达资产负债表
- 2006-2013年依利安达收入地域分布
- 2006-2013年依利安达收入技术分布by layer
- 依利安达各厂产能
- 依利安达技术能力
- 2009-2013年Express Electronics东莞厂收入
- 2009-2013年Express Electronics苏州厂收入



- SIMM TECH组织结构
- 2009-2013年SIMMTECH资产负债表
- 2013年1季度-2014年4季度SIMMTECH季度收入产品分布
- 2012-2015年SIMMTECH收入产品分布
- 2013年1季度-2014年4季度SIMMTECH季度毛利率与运营利润率
- 2013年1季度-2014年4季度SIMMTECH季度出货量
- 2012-2015年SIMMTECH出货量
- 2013年1季度-2014年4季度SIMMTECH季度产能利用率
- 2012-2015年SIMMTECH产能利用率
- 2008-2014年SIMMTECH收入by application
- 2012-2014年SIMMTECH Substrate收入by application
- 2005-2014年志超收入与毛利率
- 2005-2014年志超收入与营业利润率
- 2012年5月-2014年5月志超每月收入与增幅
- 2012年志超客户结构
- 2012年志超收入下游分布
- TPT大陆子公司财务数据
- 依顿电子股权结构
- 2007-2011年依顿电子收入与毛利率
- 2009-2013年 依顿电子收入Layer分布
- 2009-2012依顿电子收入by Region
- 2007-2012年 依顿电子收入客户结构



- 2005-2013年敬鹏收入与毛利率
- 2005-2014年敬鹏收入与营业利润率
- 2012年5月-2014年5月敬鹏每月收入与增幅
- 2006-2014年LG INNOTEK收入与运营利润率
- 2009-2014年SEMCO收入与营业利润率
- 2007-2012年方正PCB收入与运营利润率
- 2013年方正PCB子公司财务数据
- 2010年方正PCB下游应用分布
- 方正重庆厂产能
- 珠海方正一厂产能
- 珠海方正三厂产能
- 珠海方正五厂产能
- 方正杭州二厂产能by technology
- 珠海方正四厂产能
- 方正HDI技术能力
- 2005-2013年高德电子收入与运营利润
- 高德电子关系企业
- 2006-2014年定颖收入与毛利率
- 2009-2014年定颖收入与营业利润率
- 2012年5月-2014年5月定颖每月收入与增幅
- 2009-2012年定颖产能
- 2006-2014年惠亚收入与运营利润率



- 2008-2013年惠亚收入业务分布
- 惠亚全球分布
- 2008-2013年惠亚集团收入下游应用分布
- 惠亚主要客户
- 2010-2012年惠亚集团收入
- DDI收入地域和终端市场分布
- DDI工厂分布
- DDI主要客户
- 南亚电路板组织结构
- 2006-2014年南亚电路板收入与毛利率
- 2009-2014年南亚电路板收入与营业利润率
- 2012年5月-2014年5月南亚电路板每月收入与增幅
- 深南电路技术能力
- 2007-2014年沪士电子收入与运营利润
- 2010-2014年沪士电子收入by layer
- 2007-2013年沪士电子收入下游分布
- 2012\2013年沪士电子毛利率by applicatio
- 2013年沪士电子主要客户
- 2005-2014年超声电子收入与运营利润率
- 超声电子组织结构
- 2007-2013年超声电子收入业务分布
- 2008-2014年臻鼎收入与运营利润率



- 2008-2014年臻鼎收入与毛利率
- 2012年5月-2014年5月ZDT月度收入
- 2012年臻鼎大陆子公司财务报表
- 2013年臻鼎大陆子公司财务报表
- 2011-2013年Multek ELIC技术路线图
- 2011-2013年Multek 软硬板 技术路线图
- 2011-2013年Multek Microvias技术路线图
- 2004-2014年景硕收入与毛利率
- 2009-2014年景硕收入与营业利润率
- 2012年5月-2014年5月景硕每月收入与增幅
- 2011-2014年景硕收入产品分布
- 2011年景硕收入下游应用分布
- Q1/2014景硕收入BY Applications
- 2013\2014 KINSUS客户分布
- 2007-2015财年Shinko收入与净利润
- 2010-2014财年Shinko收入业务分布
- 2008-2014年ISU PETASYS收入与营业利润率
- 2012-2014年ISU PETASYS收入by technology



购买报告

价 格	电子版: 9000元	电话: 010-8260.1561
	纸质版: 9500元	传真: 010-8260.1570
页数: 185页		邮箱: hanyue@waterwood.com.cn
发布日期: 2014-7		网址: www.pday.com.cn
链接: http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201407/24511812.html		
地址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502室		

如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、
联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561

传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

